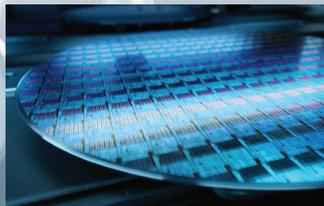


イソラスト PureFab® JPF22

優れた耐薬品性を有するウェットプロセスやECD向け
パーフロロエラストマー



アミン系薬品やプラズマプロセスガスへの優れた耐性により、ECDやその他のウェットプロセスにおけるコンポーネントの長寿命化を実現

Isolast® (以下: イソラスト) PureFab® JPF22は、半導体製造の過酷な条件に対応するために開発された高性能パーフロロエラストマー (FFKM) であり、電解メッキ (Electrochemical Deposition: ECD)、CMP (化学機械研磨)、その他のウェットプロセスにおける長寿命化とプロセス歩留まりの最大化に貢献します。

独自配合により、腐食性の高いプロセス薬品、蒸気、アミン系気相原料に対して優れた耐性を有し、長期間にわたりシール性能を発揮します。

さらに、幅広いプロセスガスにおける耐プラズマ性と低パーティクル性により、イソラスト PureFab® JPF22 は、過酷なプロセス環境でも長期的なシール性を実現します。

イソラスト PUREFAB®

イソラスト PureFab® は、過酷な半導体製造プロセス向け専用に開発されたFFKM材料群です。各グレードは、プロセス化学、システムの設置場所、装置の複雑性を考慮して最適化されており、プラズマ環境や高温条件下において高純度で卓越したシール性能を発揮します。

特長と利点

- 合成フィラーの独自配合により機械的特性の最適化と優れた圧縮永久歪み特性を実現
- +220°C (+428°F) までの温度下で、腐食性の高いアミン系薬品や一般的なドライプロセスガスに対する優れた耐性を発揮
- 低金属含有量による高いプロセス歩留まりを実現
- パーティクル発生と重量減少を最小化することで汚染リスクを低減しながら長寿命化を実現
- SEMI F40/F57に準拠した極めて低い溶出物を実現する高純度配合

用途例

- 電解メッキ (Electrochemical Deposition: ECD) 用シール
例: ウェハーシール
- CMP (化学機械研磨) やウェットエッチング向けソリューション
- アッシング / ストリッピング、プラズマエッチング、CVD、PECVD 用コンポーネント

イソラスト PUREFAB® JPF22

一般データ		イソラスト PureFab® JPF22
エラストマータイプ		FFKM
色		ベージュ
物性	テスト方法	結果
硬さ (ショア A)	ASTM D2240	80
引張強度 (MPa)	ISO 37	15.7
破断伸び (%)	ISO 37	152
100%モジュラス (MPa)	ISO 37	10.2
圧縮永久歪み (%) 72h @ +200 °C/+392 °F	ASTM D395	23
連続使用温度		~+220 °C (+428 °F)

お客様の用途に合わせたポリマーソリューション



トレルボルグでは、お客様との緊密な協業をベースとした地域ごとの専門サポート、グローバルネットワーク、そして半導体分野に精通した専任社員との連携により、設計から試作、量産まで一貫したサービスをご提供します。

詳細情報やお問い合わせ: www.trelleborg.com/seals/jp

本資料の情報は一般的な参考用であり、特定用途への適合性を保証するものではありません。製品や材料の適合性については、お客様ごとにご自身で確認する必要があります。

色のばらつき(暗点を含む)は、ポリマー硬化工程による通常の現象であり、異物の混入や性能・信頼性・清浄度への悪影響を示すものではありません。

プラズマプロセスでの使用例をインタラクティブにご覧ください

稼働時間の向上と歩留まり改善を実現する先進的なシールソリューションを、インタラクティブなウェブセクションでご覧ください。

www.trelleborg.com/ja-jp/seals/your-industry/semiconductor/dry-processing-capabilities



TRELLEBORG

WWW.TRELLEBORG.COM/SEALS